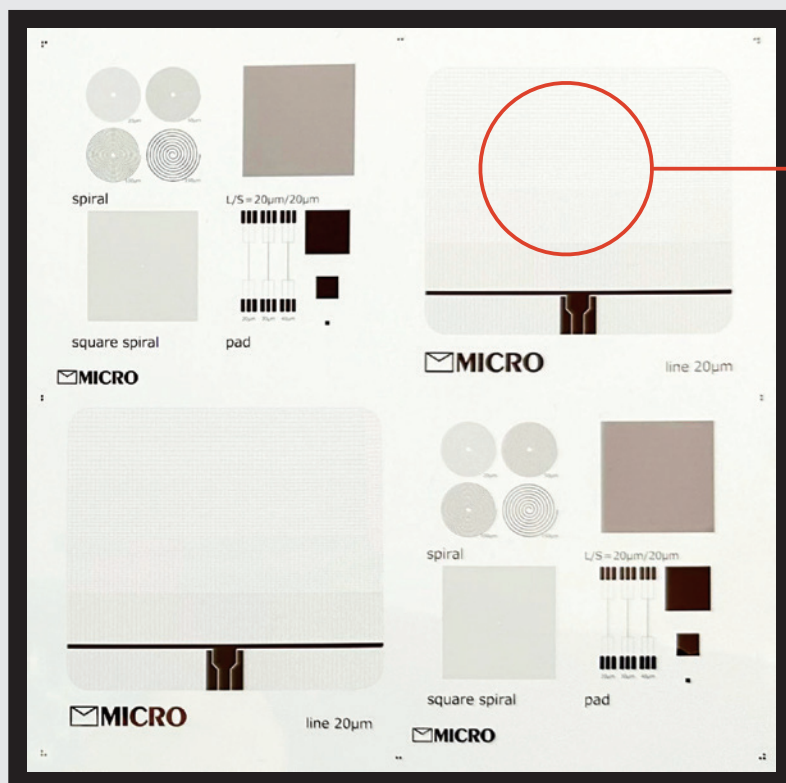


セミアディティブ銅めっき法を用い、
LCP上に**密着強度の高い電極**を形成いたします。



LCP上に1kN以上の密着強度で電極を形成

仕 様

◆素材

板 厚： 0.1mm
サイズ： 150×150mm
材 質： LCP 液晶ポリマー

◆電極

形 成： (シード層 SP Ti/Cu)+セミアディティブ銅めっき
導 体 厚： 0.2~7µm
最小線幅： L/S 10/10µm
密 着： 1kN 以上